



HPI

TE 内部编号 1-2041145-4  
HPI, PCB Mount Header, Right Angle, Wire-to-Board, 14 Position,  
2mm [.079in] Centerline, 1 Row, Tin, Natural Housing Color,  
Partially Shrouded

[在 TE 官网查看>](#)

连接器 > PCB 连接器 > 线对板连接器 > 线对板接头和插座 > AMP HPI 2.0MM 接头



PCB 连接器组件类型: **PCB 安装接头**

PCB 安装方向: **直角**

连接器系统: **线到板**

Number of Positions: **14**

中心线（间距）: **2 mm [.079 in]**

[所有 AMP HPI 2.0MM 接头 \(198\)](#)

产品特性

产品类型特性

|             |          |
|-------------|----------|
| PCB 连接器组件类型 | PCB 安装接头 |
| 连接器系统       | 线到板      |
| 接头类型        | 部分带罩     |
| Sealable    | 否        |
| 连接器和端子端接到   | 印刷电路板    |

结构特性

|                     |    |
|---------------------|----|
| 连接器端子负载状态           | 满载 |
| PCB 安装方向            | 直角 |
| Number of Positions | 14 |
| 行数                  | 1  |

电气特征

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Operating Voltage | 250 VAC |
|-------------------|---------|

接触件特性

|           |                  |
|-----------|------------------|
| 端子布局      | 直插式              |
| 端子接触部长度   | 3.35 mm[.131 in] |
| 接合方柱尺寸    | .5 mm[.02 in]    |
| 壳体內的端子定位力 | 不带               |



|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| PCB 端子端接区域电镀材料厚度   | 2.03 μm[80 μin]  |
| PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层 | 亮光               |
| 端子形状和构造            | 正方形              |
| PCB 端子端接区域电镀材料     | 锡                |
| 端子基材               | 磷青铜              |
| 端子接触部电镀材料          | 锡                |
| 端子接触部电镀材料表面涂层      | 亮光               |
| 端子接合区域电镀材料厚度       | 2.032 μm[80 μin] |
| 端子类型               | 插针               |
| 端子额定电流（最大值）        | 3 A              |

端接特性

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| 方形端接柱体和尾部尺寸   | .5 mm[.02 in]   |
| 每个柱体的端接数（最大值） | 3               |
| 端接柱体和尾部长度的    | 3.4 mm[.134 in] |
| 线缆端接方法        | 压接              |
| PCB 端接方法      | 通孔 - 焊接         |

机械附件

|            |        |
|------------|--------|
| 应力消除       | 不带     |
| 接合对准类型     | 极化, 极化 |
| 接合对准       | 带有     |
| PCB 安装固定类型 | 弯脚     |
| 接合固定类型     | 锁定     |
| PCB 安装对准   | 不带     |
| 接合固定       | 带有     |
| PCB 安装固定   | 带有     |
| 连接器安装类型    | 板安装    |

壳体特性

|         |               |
|---------|---------------|
| 中心线（间距） | 2 mm[.079 in] |
| 壳体颜色    | 土黄色           |
| 外壳材料    | 尼龙 66, 尼龙 66  |

尺寸

|       |                 |
|-------|-----------------|
| 连接器长度 | 30 mm[1.181 in] |
|-------|-----------------|



|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 连接器高度      | 5.8 mm[.228 in]            |
| 连接器宽度      | 7.7 mm[.303 in]            |
| PCB 厚度（建议） | 1 – 1.6 mm[.039 – .063 in] |

使用环境

|        |                           |
|--------|---------------------------|
| 工作温度范围 | -25 – 85 °C[-13 – 185 °F] |
|--------|---------------------------|

操作/应用

|      |        |
|------|--------|
| 电路应用 | Signal |
|------|--------|

行业标准

|          |          |
|----------|----------|
| UL 阻燃性等级 | UL 94V-0 |
|----------|----------|

包装特性

|      |     |
|------|-----|
| 封装数量 | 160 |
| 封装方法 | 袋/盒 |

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

|                                                         |                                                                                       |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 欧盟RoHS指令2011/65/EU                                      | 符合                                                                                    |
| 欧盟ELV指令2000/53/EC                                       | 符合                                                                                    |
| 中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令 | 没有超出阈值的受限材料                                                                           |
| 欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006                             | 欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2021年1月（211）<br>SvHCs候选清单的声明更新至: 2021年1月（211）<br>不含REACH SVHC |
| 卤素含量                                                    | 非低卤素 - 包含 Br 或 Cl > 900 ppm °                                                         |
| 焊接工艺能力                                                  | 波峰焊接可达到 260°C                                                                         |

产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP 的最大浓度不超过 0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU 指令要求电子电气产品需要进行 CE 标识。元器件产品通常无需进行CE 标识。经 TE 确认符合欧盟 ELV 指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过 0.01%（按重量计算），或符合指令 2000/53/EC (ELV) 附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE 目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质（SVHC）的信息是基于欧洲化学品管理局（ECHA）最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | HPI



客户还购买了



文档

产品图纸

HPI 2.0MM CONN., R/A, DIP, 14P

英文版本

CAD 文件

3D PDF

3D



下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2041145-4\\_A.2d\\_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2041145-4\\_A.3d\\_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG\\_CVM\\_CVM\\_1-2041145-4\\_A.3d\\_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意[使用条款](#)。

数据表/目录页

[HPI Connectors QRG](#)

英文版本

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

产品环境合规性

[TE 材料声明](#)

英文版本